

DENKA球形氧化铝DAM系列|DAW系列|DAB系列|电化代理商

产品名称	DENKA球形氧化铝DAM系列 DAW系列 DAB系列 电化代理商
公司名称	昆山照动贸易有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	品牌: DENKA 型号: DAM, DAW, DAB 产地: 日本denka进口
公司地址	花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号
联系电话	15962635247

产品详情

denka电化球状氧化铝，DAM系列、DAW系列、DAB系列 产品：DENKA（日本电气化学株式会社）详细说明：DAM系列：通过粒子球状化，在高导热性的基础上，增加了很多其他特性。DAW系列：大幅降低了钠离子为代表的离子性杂DAB系列：在DAW系列中添加了独自开发的超微粉三氧化二铝。概要 此产品是运用我公司独自的高温熔融技术而开发的高球形度的球状氧化铝。是适用于以赋予各种树脂、橡胶高导热性以及提高表面硬度为目的的填充材的产品。我公司还备有降低离子性杂的等级品，也适用于要求信赖性的电子材料领域。特征 容易对各种树脂、橡胶进行高度填充，而且与不定形填充材相比，可以抑制混炼机和模具的摩耗。并且可以根据用途调节粒度分布（粒径1~100 μ m）。用途

半导体密封材用填料 各种树脂填充材

适用于提高硅橡胶、环氧树脂、各种工程塑料等的导热性以及表面硬度。 陶瓷粉成用底粉 砥粒 热喷涂材料

电化球状氧化铝

产品信息

概要

此产品是运用我公司独自的高温熔融技术而开发的高球形度的球状氧化铝。是适用于以赋予各种树脂、橡胶高导热性以及提高表面硬度为目的的填充材的产品。我公司还备有降低离子性杂质的等级品，也适用于要求信赖性的电子材料领域。

特点

容易对各种树脂、橡胶进行高度填充，而且与不定形填充材相比，可以抑制混炼机和模具的摩擦。并且可以根据用途调节粒度分布（粒径1~100 μ m）。

また用途に合わせた粒度分布の調整が可能です。（粒径:サブミクロン~70 μ m）

用途

半导体密封材用填充料

陶瓷粉烧成用底粉

砥粒

热喷涂材料